

印制电路板设计

— Altium Designer 15



第9章 PCB元件封装设计

9.1 制作元器件封装

9.2 集成库的生成与维护

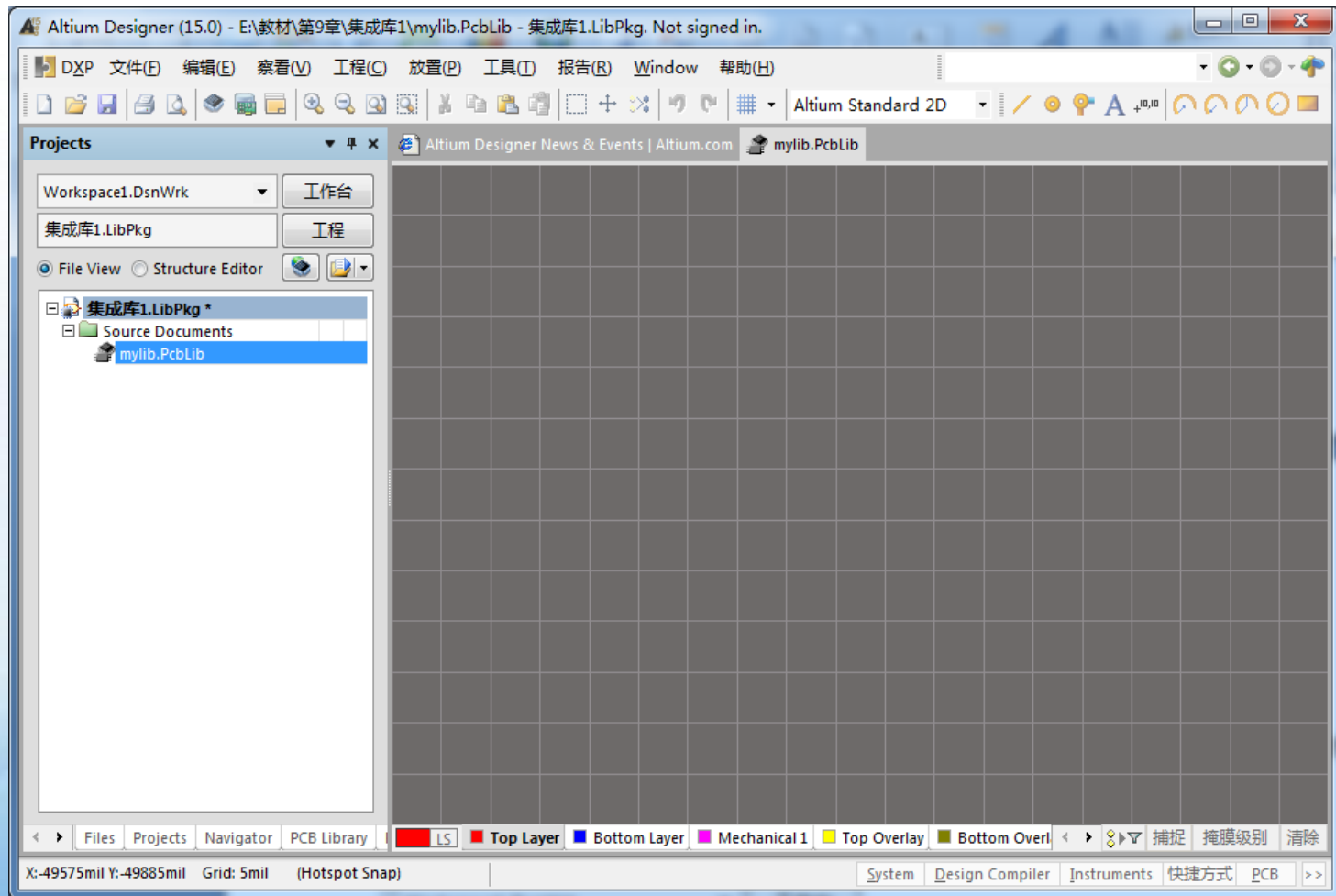
9.1 制作元器件封装

9.1.1 创建新的元件封装库

元件封装只是元件的外形和焊盘位置，仅仅是空间的概念，制作元件封装时主要关注元件的外观轮廓和焊盘。

1. 收集必要的资料
2. 绘制元件外形轮廓
3. 放置元件引脚焊盘

9.1.2 进入元件封装库管理器



9.1.3 手工制作DIP8元器件封装

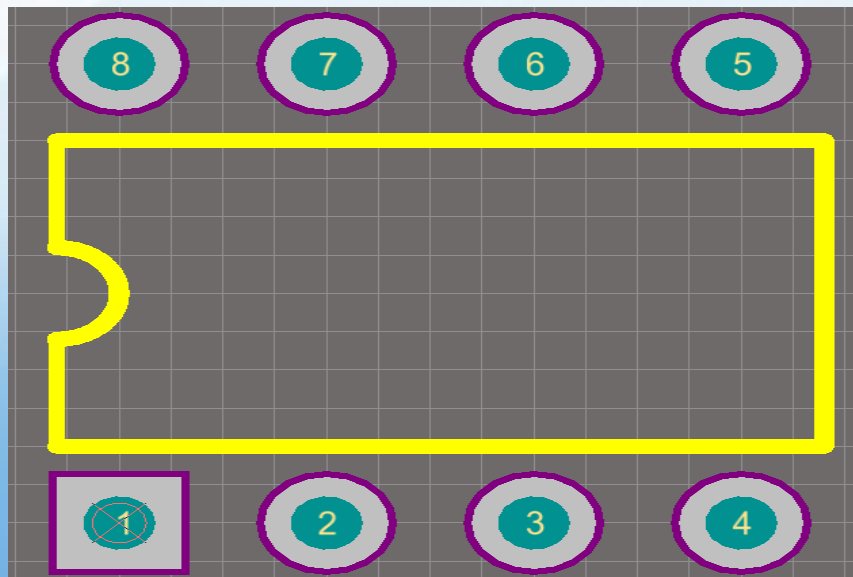
1. 启动元件封装库编辑器

要想绘制封装，首先得启动元件封装库编辑器。打开前面创建的集成库工程，双击该工程中的PCB库文件“mylib.PcbLib”，即可启动元件封装库编辑器。

2. 放置焊盘

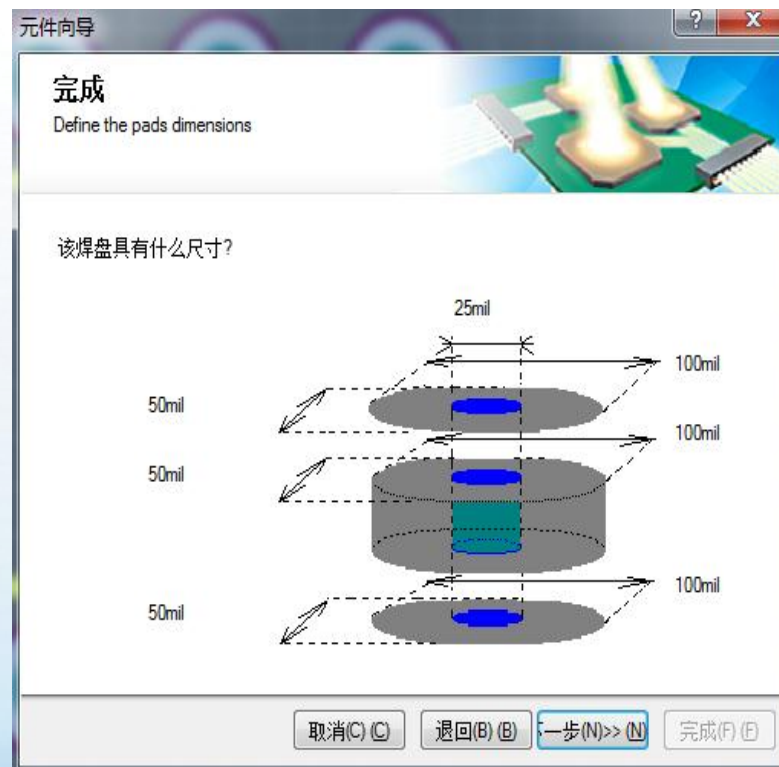
所谓焊盘就是电路板上用来焊接元器件或电线等的铜箔，只有焊盘的位置和大小适当，元器件才可能被有效安装并焊接。

3. 绘制外形轮廓
在顶层丝印层，使用放置导线工具和绘制圆弧工具绘制元件封装的外形轮廓。

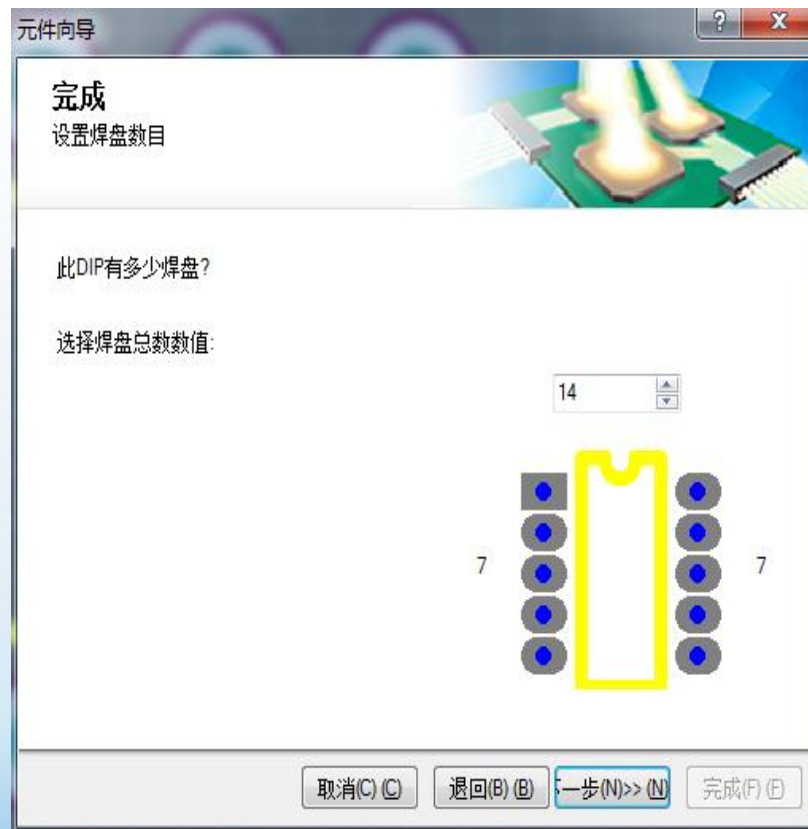
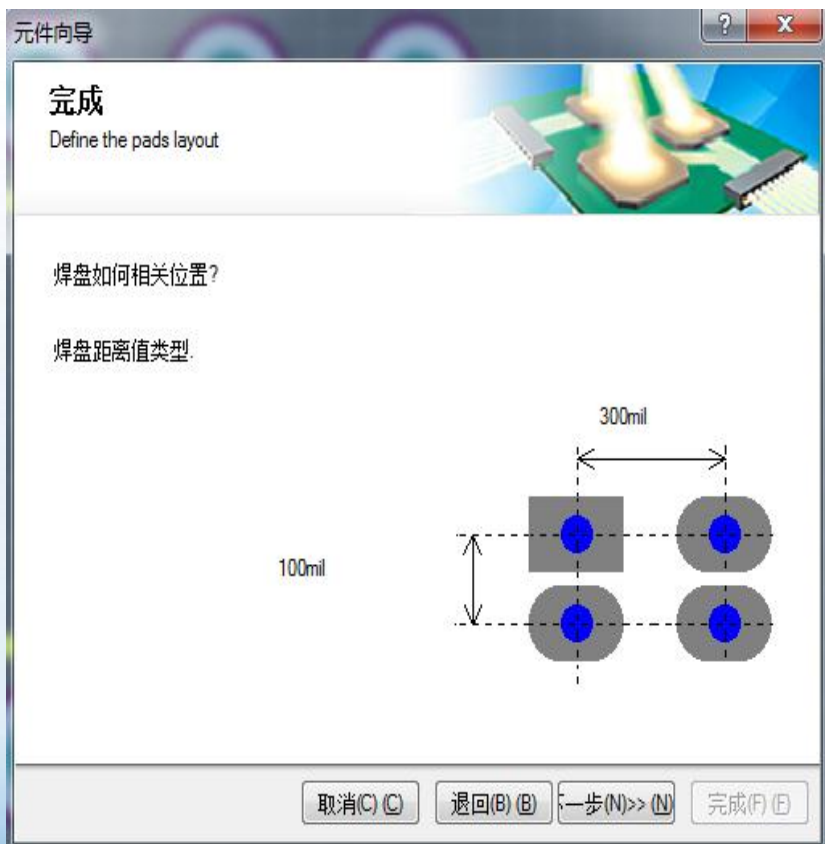


9.1.4 利用向导工具制作DIP14元件封装

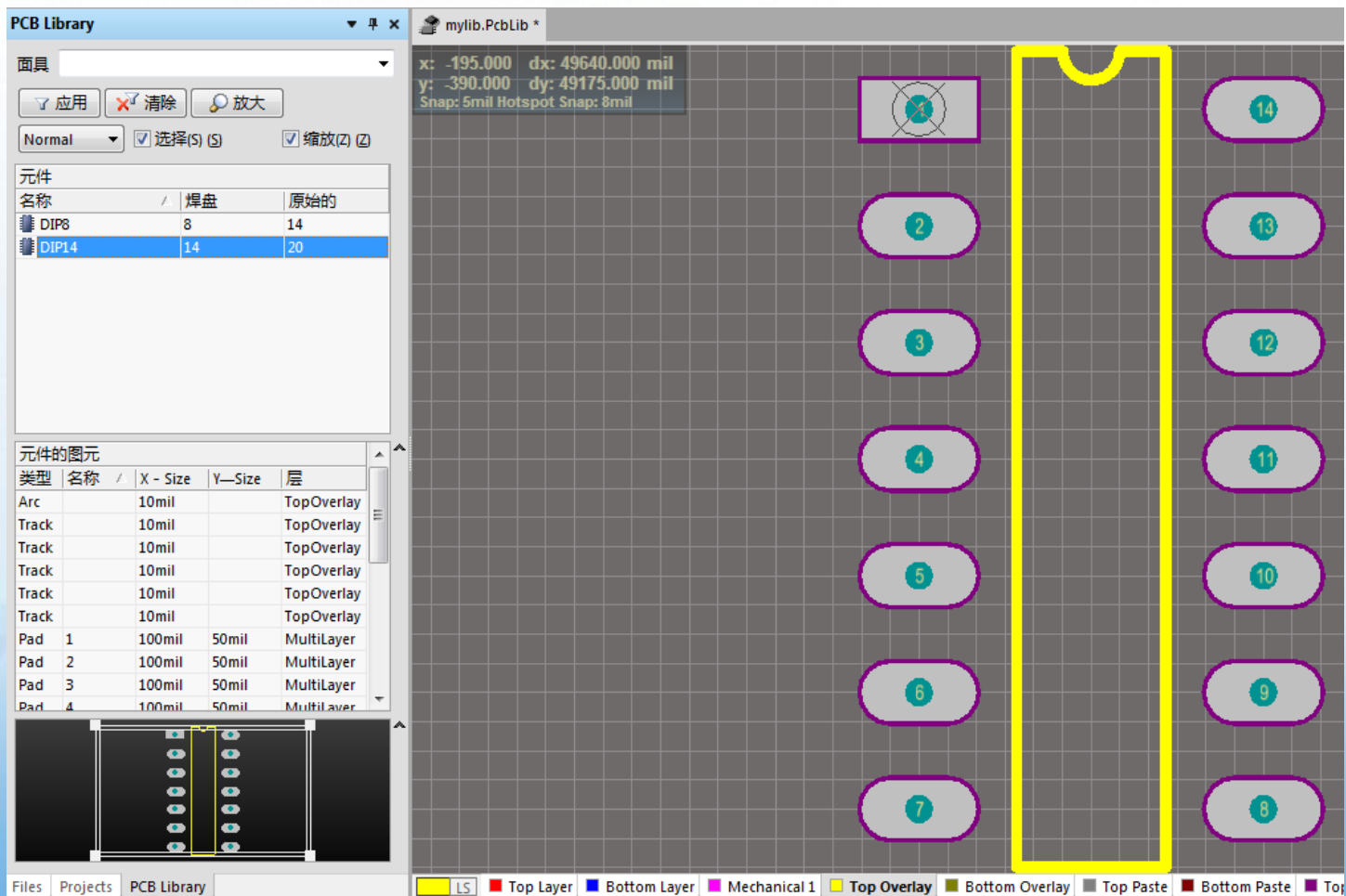
2.启动PCB封装向导



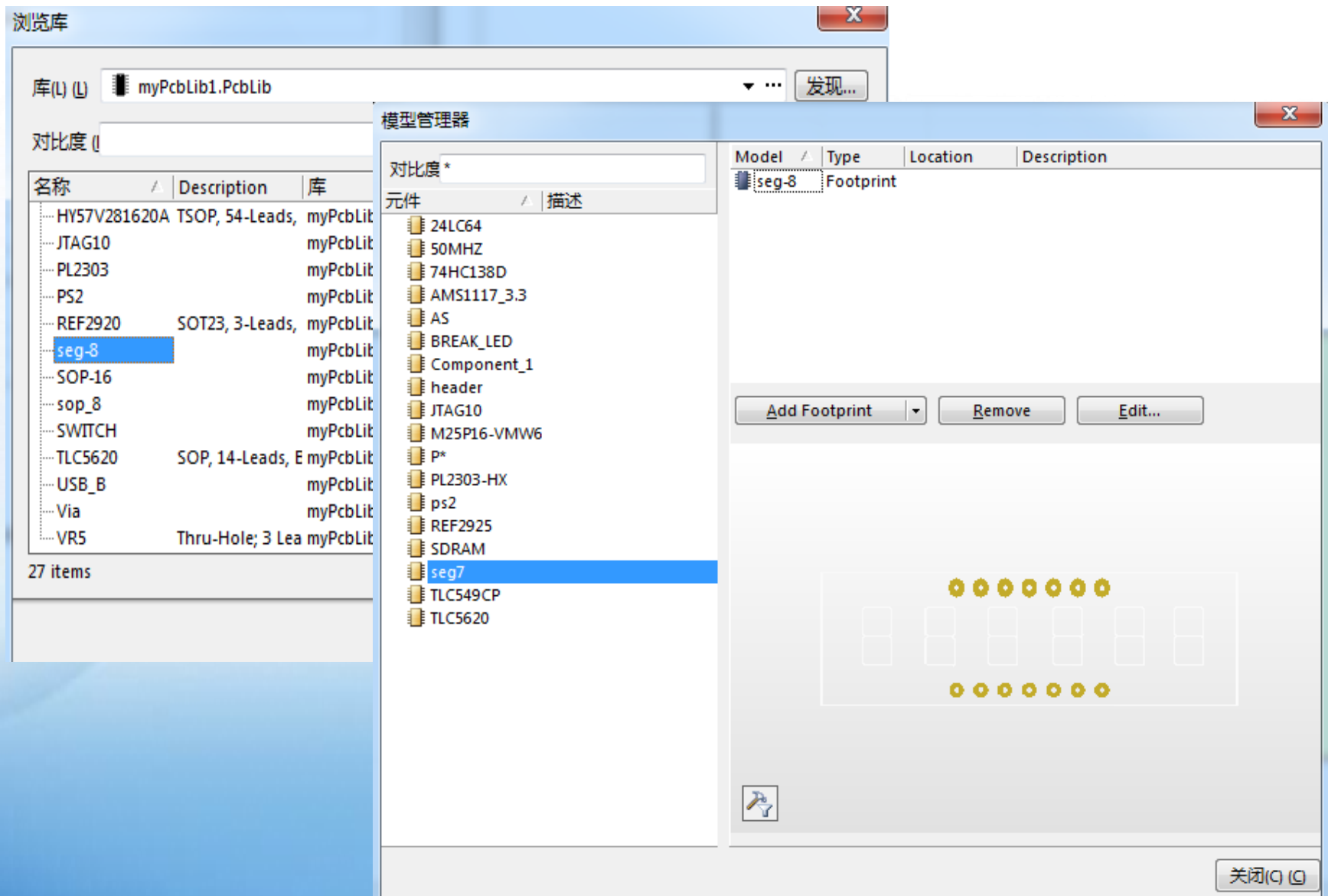
9.1.4 利用向导工具制作DIP14元件封装



9.1.4 利用向导工具制作DIP14元件封装



9.2 集成库的生成与维护





THANK YOU !